

# KYOTO DOCTORAL CAREER FORUM 2023

主催：京都クオリアフォーラム 人材育成WG

## 第一部：博士学生への期待とキャリアを考える

参加無料

### 趣旨

博士に対する期待や現状を本音で語りあい、博士後期課程の学生を京都・奈良で盛り上げるための第一歩として、「文部科学省技術イノベーション創出に向けた大学フェロシップ創設事業」「JST 次世代研究者挑戦的研究プログラム」に採択された京都・奈良の6大学が連携して企画しました。

### 社会を知る

キャリア選択肢を広げるきっかけの場

### 交流

求められている人材を知る場、異分野や他大学・企業の研究から知識の幅を広げ研究の悩み解消の場

### スキルアップ

自身の強みを専門家以外にも知ってもらい、対話や発表スキルを養う場

### 博士を知る

人材イメージをつかみ、博士課程で学ぶ魅力を感じる場

### 共に育てる

京都・奈良に根差す企業・大学・自治体が、組織の垣根を越えて世界をリードする高度専門人材を育て、未来のワクワク、希望を感じられる社会へ

### PROGRAM

12:00

開会挨拶 京都工芸繊維大学 吉本 昌広 理事・副学長

12:05

登壇者紹介 トータルコーディネーター 京都工芸繊維大学 高田 隆裕 特任教授

12:10

Part1 社会人博士のプレゼンテーション (8分/1名+Q&A 20分)

//ハイブリッド// ZOOM / 立命館大学 朱雀キャンパス

12:10

司会 | 京都工芸繊維大学 高田 隆裕 特任教授

村田機械(株) 三浦 崇寛 博士(工学)

12:55

大谷大学 野村 実 講師・博士(社会学)

(株)村田製作所 細野 新 博士(工学)

休憩

13:05

司会 | 京都府立医科大学 曾和 義広 特任教授

(株)SCREEN ホールディングス 國枝 省吾 博士(工学)

14:00

京都府中小企業技術センター 鴨井 督 博士(工学)

京セラ(株) 堂本 千秋 博士(工学)

同志社大学 迫田 さやか 准教授・博士(経済学)

休憩

14:10

司会 | 京都産業大学 横山 謙 教授

(株)島津製作所 杉村 佳織 博士(理学)

14:55

京都産業大学 西田 貴明 准教授・博士(理学)

(株)堀場アドバンステクノ 川口 佳彦 博士(工学)

休憩

15:10

司会 | 立命館大学 RARA オフィス 山菅 善樹 課長

博士学生向けインターンシップの紹介

(京セラ(株)、(株)島津製作所、(株)SCREEN ホールディングス、

16:00

(株)堀場製作所、NISSHA(株))

//対面// 立命館大学 朱雀キャンパス

16:20

Part2 学生と社会人の交流会 (25分×2巡・参加者限定)

17:20

閉会の挨拶・全体講評 (株)SCREEN ホールディングス 灘原 壮一 顧問

17:30

2023 **7/10** (Mon.) **12:00⇒17:30**

ハイブリッド開催・参加無料(事前登録制)

プレゼン:オンライン&対面\* 交流会:対面\* | \*会場:立命館大学朱雀キャンパス

参加対象

京都クオリアフォーラム参加企業の社員・自治体関係者

京都クオリアフォーラム参加大学の教職員・博士後期課程在籍/進学希望の大学院生

▶ 博士キャリアメッセ KYOTO 第2部:博士学生のショートプレゼンは、11/7(Mon.)-8(Tue.)を予定しています。



参加申込専用フォーム  
<https://forms.gle/mPYLGr1wQYMP2kjK7>

申込締切: **6/20(Tue.)**

※申込者多数の場合は調整する場合があります。ご了承ください。

本件は、「文部科学省・科学技術イノベーション創出に向けた大学フェロシップ創設事業」「JST 次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)」参加大学がイベント事務局として連携しております。

■ 博士キャリアメッセKYOTO事務局(50音順):

京都工芸繊維大学、京都産業大学、京都府立医科大学、同志社大学、奈良先端科学技術大学院大学、立命館大学

● 京都クオリアフォーラム参加企業: 京セラ株式会社、三洋化成工業株式会社、株式会社島津製作所、株式会社SCREENホールディングス、NISSHA株式会社、株式会社堀場製作所、村田機械株式会社、株式会社村田製作所

● 京都クオリアフォーラム参加大学: 京都工芸繊維大学、京都産業大学、京都府立大学、京都府立医科大学、同志社大学、奈良先端科学技術大学院大学、立命館大学

■ お問い合わせ先: 京都工芸繊維大学 学生支援・社会連携課 キャリア支援・社会連携係 Tel: 075-724-7149 / mail: doc@jim.kit.ac.jp